

公司代码：688630

公司简称：芯碁微装



合肥芯碁微电子装备股份有限公司

2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第一届董事会第十七次会议审议，公司 2021 年度利润分配方案拟定如下：以本次权益分派股权登记日总股本 120,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计分配现金股利人民币 24,160,000.00 元（含税），不送股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

上述利润分配预案已由独立董事发表独立意见，该利润分配预案需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称

A 股	上海证券交易所 科创板	芯碁微装	688630	/
-----	----------------	------	--------	---

公司存托凭证简况

适用 不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	魏永珍	刘琴
办公地址	合肥市高新区长宁大道789号	合肥市高新区长宁大道789号
电话	0551-63826207	0551-63826207
电子信箱	yzwei@cfmee.cn	qliu@cfmee.cn



2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务及主营产品

公司专业从事以微纳直写光刻为技术核心的直接成像设备及直写光刻设备的研发、制造、销售以及相应的维保服务，主要产品及服务包括 PCB 直接成像设备及自动线系统、泛半导体直写光刻设备及自动线系统、其他激光直接成像设备以及上述产品的售后维保服务，产品功能涵盖微米到纳米的多领域光刻环节。

主要产品及应用领域如下表所示：

	产品系列	产品型号	产品图示	主要应用领域
PCB 直 接 成 像 设 备	MAS 系列	MAS15 MAS25 MAS35 MAS40		类载板、软板/软硬结合板、HDI 板、多层板和单/双面板等线路曝光制程。
	RTR 系列	RTR15 RTR25 RTR35		高性能、卷对卷直接成像系统，采用高精度的成像和定位系统结合卷对卷上下料系统，为 FPC 软板制程提供完美的解决方案。

	NEX 系列	NEX3T NEX-W		新一代的一款高性能防焊 DI 直接成像系统，采用大功率曝光光源设计，并结合高精度的成像和定位系统，为阻焊制程提供解决方案。
	DILINE 系列	DILINE-MAS DILINE-NEX DILINE-FAST35		直接成像联机自动线，为自动化和智能化 PCB 工厂提供解决方案，适用于 IC 封装基板、类基板、软板/软硬结合板、HDI 板、多层板和单双面板等线路及阻焊制程，提高产能及效率。
	FAST 系列	FAST35		该系列是一款高产能、占地尺寸小的高性能直接成像 LDI 解决方案，采用高速运动平台，并结合高精度的成像和定位系统，为 PCB 黄光制程提供的解决方案。
泛 半 导 体 设 备	LDW 系列	LDWX6 LDWX9		用于 IC 掩膜版制版、IC 芯片、MEMS 芯片、生物芯片等直写光刻，光刻精度能够达到最小线宽 350nm-500nm，能够满足线宽 90nm-130nm 制程节点的掩膜版制版需求。

	MLL 系列	MLL-C500 MLL-C900		自主研发生产的一款精巧型光刻设备，广泛应用 IC 芯片、掩模版、MEMS 芯片、生物芯片微纳光刻加工领域的研究与生产，光刻最小线宽 600nm，套刻对准精度 500 nm。
	WLP 系列	WLP-8		应用于晶圆级封装、系统级封装、板级封装、功率器件、分立元件等先进封装和芯片制造领域的量产型直写光刻，支持先进封装及芯片制造的 RDL 功能，适用于中试、生产等量产产线使用。
	FPD 解决方案	LDW-D1		该产品应用于 OLED 显示面板制造过程中的光刻工艺环节，光刻精度能够实现最小线宽 0.7 μ m。
	IC 载板解决方案	Mas6 Mas8		该产品应用于 IC 载板的曝光制程，光刻精度能够实现最小线宽 6 μ m。

(二) 主要经营模式

(1) 盈利模式

公司主要通过向下游 PCB 领域、泛半导体领域的客户销售设备并提供相应的周期性设备维保服务实现营业收入及利润。此外，公司还提供少量的设备租赁，并在租赁期内收取租赁费。

(2) 研发模式

公司导入了 IPD 研发管理体系，研发模式以自主研发为主，技术开发管理部 IPD 项目组是研发项目的归口管理部门，负责组织项目立项、评审和验收等管理工作。报告期内，公司对研发部门进行了调整，分别为承担基础研发工作的技术研发中心（进行前瞻性技术研究和公共技术模块开发以有效支撑各产品线产品开发）、以及进行各类产品线开发的泛半导体产品线、PCB 产品线、自动线产品线。

公司按照集成产品开发 IPD 模式进行产品开发，主要研发流程包括：（1）根据市场、客户需求及技术发展趋势，市场部门与产品线配合进行充分市场调研后发起项目立项并制定初步产品开发计划；（2）立项通过后，进行系统架构和核心技术可行性的分析验证，并确认产品开发计划；（3）系统详细设计，包括系统子模块设计（光学模块、机械模块、电子模块、数据电子及软件）和诸可性设计（可测试性、可维护性、可靠性等）（4）详细设计通过审核后，进入研发样机制造与测试验证；（5）研发样机验证通过后，安排小批量进行可生产性验证，并安排客户端验证；（6）客户端验证通过后，移交产品制造中心进行量产，转入产品生命周期维护阶段。——在整个研发过程阶段节点，会分别从技术和商业成功两条主线安排评审，确保产品开发结果符合预期。

（3）采购模式

在产品制造过程中，所需的主要材料包括核心组件和零部件。针对运动平台及组件、图形生成模块、光路组件、曝光光源、自动控制组件等核心组件及非标准零部件，公司通过提供设计方案、图纸和参数委托选定的优质供应商定制生产；或因为功能模块的特殊需求以及出于成本控制和供应链安全的考虑，公司在评估模块自设计和集成能力的前提下，通过购买标准核心组件后再进行二次开发。针对常规标准零部件，公司面向市场进行独立采购。

为保证核心组件、零部件的品质，公司制定了严格、科学的采购制度，从供应商选择、价格谈判、质量检验到物料入库的全过程，均实行有效的内控管理。具体采购方式有以下三种：（1）谈判式采购：对于核心组件和非标准零部件，为了确保产品的质量可靠，只备选国内外几家知名的供应商，建立稳定的合作关系，定期谈判以最优供货条件确定最终的供货方；（2）竞争性采购：对于常规标准零部件采取竞争性采购，遴选的条件包括质量、价格、付款条件、交期、服务等；（3）零星采购：对于价值低且需求量大的零部件，采用网上询价的方式。

对于部分交货期较长的进口核心组件，为缩短公司产品交货期，公司根据市场及订单情况预测做适量的策略性库存储备。为保证核心组件和零部件的供货质量，公司建立了供应商考核评价体系，根据质量、价格、交期等考核指标对供应商进行综合评分，优胜劣汰。

（4）生产模式

按照产品特点及市场销售规律，公司采用“标准化生产+定制化生产”安排生产计划，主要采用自主生产模式，部分电路板焊接等非核心工序委托外协厂商生产。

A：标准化生产+定制化生产

标准化生产模式主要是针对 PCB 直接成像设备的生产。PCB 直接成像设备主要用于 PCB 规模化量产，一般情况下客户的定制化需求较少，客户需求标准相对统一，该设备主要采用标准化的

生产模式。该模式下，公司根据客户下达的订单情况和对市场的需求预测来制定生产计划。对于市场需求稳定、销量高的设备，公司会维持一定数量的产品库存，以保证较短的交货周期。

定制化模式主要针对高端战略客户进行产品开发。此类产品需要根据客户的定制需求进行研发、生产，故主要采用定制化生产模式，实行以销定产。

B：自主生产+外协生产

生产过程中的零部件和模块组装、物理光学调试等核心工序由公司自主独立完成，公司从合作供应商处采购电子元器件、PCB 等原材料，然后将电路板焊接等非核心工序委托外协厂商完成。外协生产模式下，公司向外协厂商提供电子元器件、PCB 等原材料，外协厂商按照公司的产品规格、图纸、质量标准和工艺流程文件进行生产。市场上可供选择的同类型外协厂商较多，公司不存在依赖单一外协厂商的情形。

(5) 销售模式

公司采用直销为主，经销为辅的销售模式。

首先，公司获取客户资源的方式分为五种情况：一是公司随着产品性能及服务口碑的提升，建立了很好的品牌知名度，客户主动获取公司信息，与公司进行商洽；二是公司根据业务规划，主动与相关领域内的客户取得联系；三是已有的存量客户有新需求后，与公司进一步合作；四是公司通过展会、专业协会、技术交流会等相关活动获取客户信息；五是公司通过经销商、代理商获取客户信息。

其次，在销售与服务机构的设置方面，公司设有深圳分公司、苏州子公司、台湾办事处等，能够覆盖华南、华东、华中以及台湾地区的市场销售及售后服务。同时，报告期内，公司通过经销代理商模式拓展海外市场。通过多年的市场积累，公司的成功销售案例在下游客户市场中建立了良好的口碑，为公司开拓新客户提供了良好的市场基础。

第三，在销售服务的内部部门协同方面，公司的市场部、研发部门与客户有着良性且深入的沟通，切实解决客户的痛点问题，维持和不断强化与客户之间良好的供销关系。

第四，公司设备销售主要有三种形式：（1）直接与客户签订销售合同；（2）与客户先签订试用合同，试用期满后确认合格后再进一步签署销售合同。随着公司品牌及影响力提升，与客户签订试用合同的销售模式占比很小。（3）与经销代理商签署合同，由其负责相关区域产品推广及销售。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司生产的直接成像设备及自动线系统、直写光刻设备及自动线系统主要应用在下游 PCB 行业、泛半导体行业的制造环节，设备的市场需求同下游 PCB、泛半导体产业的繁荣程度紧密相关，具体可以进一步细分为 PCB、半导体及显示行业。

(1) PCB 行业情况

PCB 板是承载电子元器件并连接电路的桥梁，作为电子产品之母，广泛应用于通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等领域，其行业发展呈现如下趋势：

①全球 PCB 行业规模大，国内 PCB 市场占有率不断提升，产业向国内转移趋势明显

据 PrismaMark 预估，2021 年全球 PCB 产值约为 804.49 亿美元，同比增长约 23.4%；预计 2021-2026 年全球 PCB 产值复合增长率约为 4.8%，2026 年全球 PCB 产值将达到约 1,015.59 亿美元。根据 PrismaMark 数据，2021 年中国 PCB 产值 350 亿美元，占全球的 43.5%；2021-2026 年中国 PCB 产值复合增长率约为 4.6%，预计到 2026 年中国 PCB 产值将达到约 546.05 亿美元，占全球的 53.8%。随着通信、服务器、数据存储及新能源等领域需求的持续拉动，叠加贸易争端及新冠疫情等因素，全球 PCB 产业往中国转移态势明显。

②高端 PCB 产品占比不断提升

随着下游电子产品向便携、轻薄、高性能等方向发展，PCB 产业逐渐向高密度、高集成、细线路、小孔径、大容量、轻薄化的方向发展，PCB 产品结构不断升级。多层板、HDI 板、柔性板中高阶 PCB 产品市场份额占比不断提升，根据 PrismaMark 预测，预计到 2025 年，HDI、柔性板、类载板等占比将提升至 52.6%。

③服务器/数据存储、汽车产业、手机、通信板块等行业 PCB 需求强劲

从产品结构上看，根据 PrismaMark 预测，如下图所示，2021-2026 年服务器/数据存储、汽车产业、手机、通信板块对 PCB 需求呈现高增长态势。

2021-2026全球PCB产值复合增长率预测（应用领域）

产值单位：百万美元

应用领域	2020	2021 预估	2026 预测	2021-2026 复合增长率
计算机：PC	11,190	14,858	14,729	-0.2%
服务器/数据存储	5,876	7,812	12,574	10.0%
其他计算机	3,801	4,624	5,069	1.9%
手机	13,980	16,025	21,165	5.7%
有线基础设施	4,968	6,111	7,901	5.3%
无线基础设施	2,771	3,237	4,242	5.6%
其他消费电子	9,466	11,790	14,969	4.9%
汽车	6,507	8,192	11,770	7.5%
工业	2,563	3,196	3,816	3.6%
医疗	1,273	1,497	1,728	2.9%
军事/航空航天	2,824	3,109	3,596	3.0%
合计	65,218	80,449	101,559	4.8%

数据来源：PrismaMark 研究报告

④PCB 行业保持良好增长态势，持续拉动曝光设备需求

随着 PCB 产业规模不断增长、产业向国内转移，同时服务器/数据存储、汽车产业、手机、通信板块等行业对 PCB 强劲需求，给 PCB 曝光设备带来了新增的市场机会；其次，PCB 产品往高阶

发展，催生现有 PCB 曝光设备的更新换代，直接成像设备替代现有传统曝光设备需求强劲。

(2) 半导体行业情况

在半导体领域，公司直写光刻设备可用于制版，IC、功率分立器件、MEMS 等芯片的制造、先进封装、封装基板制作等领域。行业发展呈现如下趋势：

①多领域细分行业增长迅速，共同带动光刻设备规模增长

➤ IC 载板下游需求强劲，国产替代进程加速

根据 prisma 数据，2022 年全球 IC 载板产值预计为 88 亿美元，预计 2025 年中国 IC 载板产值将会达到 412 亿元，增量来源于存储芯片和 MEMS 等领域的推动。受疫情及贸易摩擦影响，IC 载板国产替代加速推进，国内厂商积极投建 IC 载板项目。

➤ 先进封装复合增长迅速，光刻设备需求增加

Yole Developpement 预测，随着后摩尔时代到来，先进封装市场预计将在 2019-2025 年间以 8% 的复合年增长率增长，市场规模在 2025 年将达到 420 亿美元，预计 2027 年国内先进封装市场规模达到 667.4 亿元，占封装市场规模的 18.53%。封装厂商积极布局先进封装业务，由此带来的光刻设备需求不断增加。

➤ 引线框架往高集成方向发展，国产替代诉求迫切

集成电路封装向高集成、高性能、多引线、窄间距为特征的高密度方向发展，刻蚀类引线框架需求及占比不断增加。引线框架国内厂商市占率不足 5%，疫情、供应链安全导致行业缺货严重，国产替代诉求较为迫切。

➤ 新能源及汽车领域拉动功率器件市场需求

在功率及分立器件市场，新能源及汽车领域带来强劲需求，国产替代空间大，根据 IHS 的数据，2020 年全球功率半导体市场规模为 422 亿美元，同比增长 4.6%，其中，中国功率半导体市场规模为 153 亿美元，同比增长 6.3%。IGBT 是目前发展最快的功率半导体器件之一，据集邦咨询数据，中国是全球最大的 IGBT 市场，受益于新能源、新能源汽车、工业控制等领域的需求大幅增加，中国 IGBT 市场规模将持续增长，到 2025 年，中国 IGBT 市场规模将达到 522 亿人民币，年复合增长率达 19.11%。

②全球半导体设备需求屡创新高，我国半导体设备迎来国产替代良好契机

根据 SEMI 数据，2021 年半导体制造设备全球销售总额将达到 1030 亿美元的新高，比 2020 年的 710 亿美元的历史记录增长 44.7%。预计 2022 年全球半导体制造设备市场总额将扩大到 1140 亿美元。过去 5 年（2017-2021 年 Q3）国内半导体设备销售额增速较全球增速平均高出 17.4%，

国内需求明显强劲。随着全球贸易争端、新冠疫情反复的影响，加之我国大力扶持半导体产业发展，国产设备迎来进口替代良好契机。

③公司半导体市场应用场景不断拓展，直写光刻技术优势凸显

在全球经济步入后疫情时代，加之国际贸易形势多变，上述半导体细分市场迎来发展机遇，公司充分利用半导体市场快速增长的态势，结合公司在直写光刻技术领域的领先及品牌优势，与半导体大客户建立战略合作，迅速拓展了 IC 载板、先进封装、引线框架等市场。

(3) 新型显示快速增长，公司设备覆盖产业链多个环节

①Mini/Micro-LED /micro-OLED 等新型显示快速增长

据 Arizton 预测，2021-2024 全球 Mini LED 市场规模有望从 1.5 亿美元增至 23.2 亿美元，其间每年同比增速皆高达 140%以上。

②2021 年为 Mini 背光方案放量元年

苹果三星相继推出相关产品，TV、IT 应用商业化加速渗透。2021 年为 Mini LED TV 放量元年，出货量有望突破 400 万台，快速放量至 OLED 的 60%。Omdia 预测 2025 年全球 Mini LED 背光 TV 产品销量将增至 5280 万台，2019-2025 CAGR 53.73%。车载屏等同时会促进 Mini-LED 放量。

③公司设备覆盖产业链多个环节

Mini-LED 产业链可大致分为芯片、封装/巨量转移与打件、面板、系统（组装）、品牌五个环节，公司设备可用于封装、基板制作等。随着厂商加速对新型显示投资，由此带来的光刻设备需求增加。

(4) 主要技术门槛

光刻设备产业属于技术密集型、资金密集型产业，具有较高的技术、资金门槛，设备涵盖多门学科（光、机、电、软、算）的综合技术应用，在核心技术研发上具有研发周期长、研发风险高和研发投入大等特点。随着 PCB 及泛半导体应用环境的不断发展，电子器件结构趋于复杂，集成度越来越高，对光刻设备相关性能指标提出了更高的要求。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内最早从事直写光刻设备开发的企业之一，是国内首家光刻设备上市公司。核心技术团队成员具备三十多年的高端装备开发经验，深耕行业多年。凭借着产品技术、服务及品牌优势，公司在泛半导体领域打破了国际垄断，产品性能已比肩国际厂商，产品技术及市场份额国内领先。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

全球泛半导体、PCB 行业需求增长强劲，叠加贸易争端及新冠疫情等因素，产业往中国转移态势明显，国产替代进程加速，国产设备厂商迎来历史性机遇。随着高端芯片及 PCB 占比不断提

升，新能源、汽车、服务器、存储器细分行业政策及需求的持续拉动，新型显示等应用场景的增加，厂商投建进程加快，对应光刻设备需求不断增加。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	1,263,571,429.80	622,525,983.13	102.97	467,725,320.80
归属于上市公司股东的净资产	931,109,907.23	408,594,422.41	127.88	337,333,078.27
营业收入	492,245,130.08	310,087,589.97	58.74	202,261,172.30
归属于上市公司股东的净利润	106,157,288.87	71,038,944.04	49.44	47,625,111.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,726,368.67	54,928,609.60	57.89	46,270,020.54
经营活动产生的现金流量净额	30,218,720.60	-59,709,625.58	150.61	-15,876,304.71
加权平均净资产收益率(%)	13.72	19.05	减少5.33个百分点	29.04
基本每股收益(元/股)	0.94	0.78	20.51	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.94	0.78	20.51	0.60
研发投入占营业收入的比例(%)	11.47	10.95	增加0.52个百分点	14.12

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	81,409,797.30	104,894,517.13	105,486,829.85	200,453,985.80
归属于上市公司股东的净利润	13,012,367.31	30,143,401.11	20,053,188.35	42,948,332.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,719,973.01	25,320,429.58	13,364,540.19	35,321,425.89
经营活动产生的现金流量净额	-6,513,637.94	-3,139,509.83	-7,498,421.20	47,370,289.57

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)								7,249
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								6,417
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)								不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)								不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)								不适用
前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
程卓	0	36,787,490	30.45	36,787,490	36,787,490	无	0	境内 自然 人
合肥亚歌半导体 科技合伙企业(有 限合伙)	0	12,600,000	10.43	12,600,000	12,600,000	无	0	境内 非国 有法 人
景宁顶擎电子科 技合伙企业(有限 合伙)	0	7,980,690	6.61	7,980,690	7,980,690	无	0	境内 非国 有法 人
苏州中和春生三 号投资中心(有限 合伙)	0	4,999,982	4.14	4,999,982	4,999,982	无	0	境内 非国 有法 人

合肥康同股权投资合伙企业(有限合伙)	0	4,612,891	3.82	4,612,891	4,612,891	无	0	境内非国有法人
上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)	0	3,643,749	3.02	3,643,749	3,643,749	无	0	境内非国有法人
海通资管汇享芯碁微装员工战略配售集合资产管理计划	0	3,020,244	2.5	3,020,244	3,020,244	无	0	其他
合肥市创新科技风险投资有限公司	0	2,599,236	2.15	2,599,236	2,599,236	无	0	国有法人
国投(宁波)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙)	0	2,363,414	1.96	2,363,414	2,363,414	无	0	境内非国有法人
深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	2,226,469	1.84	2,226,469	2,226,469	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明				程卓为合肥亚哥半导体科技合伙企业(有限合伙)普通合伙人,景宁顶擎电子科技合伙企业(有限合伙)普通合伙人杨国庆为程卓姐姐之配偶。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				不适用				

存托凭证持有人情况

适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

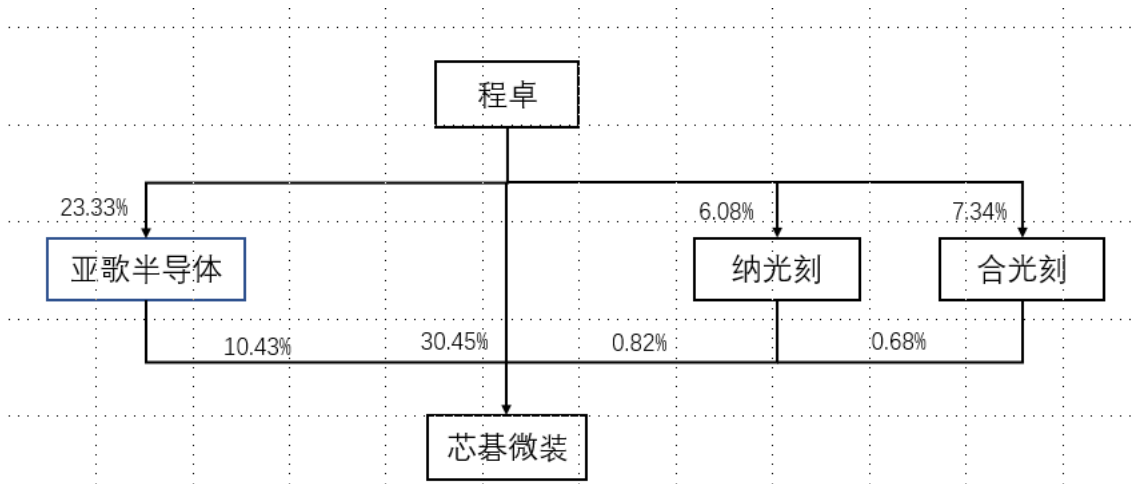
单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	程卓	36,787,490	0	36,787,490	30.45		不适用
2	合肥亚歌半导体科技合伙企业(有限合伙)	12,600,000	0	12,600,000	10.43		不适用
3	景宁顶擎电子科技合伙	7,980,690	0	7,980,690	6.61		不适用

	企业（有限合伙）						
4	苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）	4,999,982	0	4,999,982	4.14		不适用
5	合肥康同股权投资合伙企业（有限合伙）	4,612,891	0	4,612,891	3.82		不适用
6	上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）	3,643,749	0	3,643,749	3.02		不适用
7	海通资管汇享芯碁微装员工战略配售集合资产管理计划	3,020,244	0	3,020,244	2.5		不适用
8	合肥市创新科技风险投资有限公司	2,599,236	0	2,599,236	2.15		不适用
9	国投（宁波）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,363,414	0	2,363,414	1.96		不适用
10	深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,226,469	0	2,226,469	1.84		不适用
合计	/	80,834,165	0	80,834,165	/	/	/

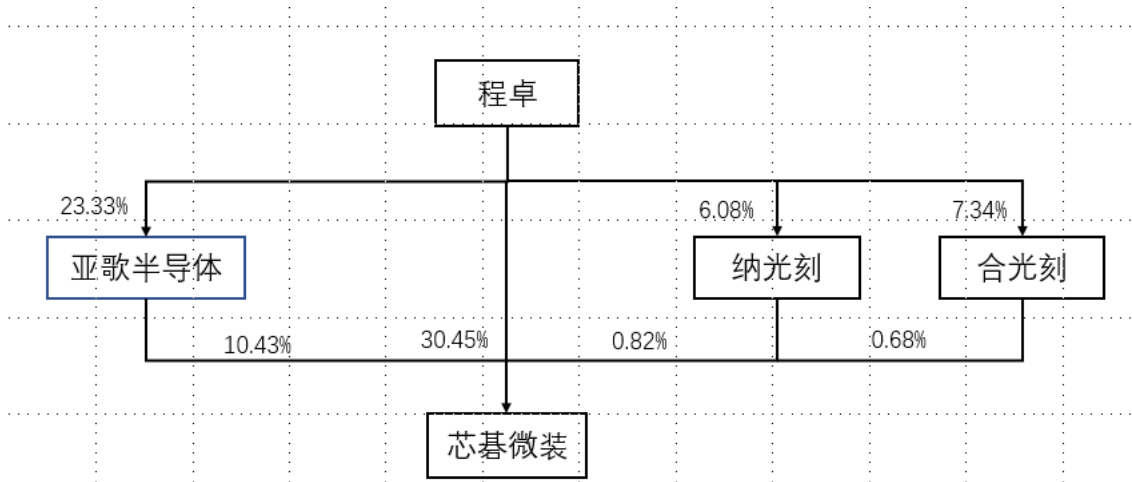
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 49,224.51 万元，同比增长 58.74%；实现归属于上市公司股东净利润 10,615.73 万元，同比增长 49.44%。公司主要业务增长来自于 PCB 及泛半导体领域业务增长，其中 PCB 业务同比增长 47.61%；泛半导体业务增长迅速，同比增长 393.49%。报告期内经营活动产生的现金流量净额 3,021.87 万元，同比上升 150.61%，主要系营业收入规模增加，回款力度加大所致。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用